

普冉半导体（上海）股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“普冉股份”）于2025年7月1日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（本文简称“募投项目”）“总部基地及前沿技术研发项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经据中国证券监督管理委员会于2021年06月22日出具的《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111号），公司获准向社会公开发行人民币普通股905.7180万股，每股发行价格为人民币148.90元，本次发行募集资金总额为134,861.41万元，扣除不含税发行费用人民币10,306.87万元后，实际募集资金净额为人民币124,554.54万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年08月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10839号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于2021年08月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司截至2024年12月31日募投项目及募集资金存放与实际使用情况详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站的《普冉半导体（上海）股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

二、 募集资金投资项目的的基本情况

根据《普冉半导体（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及公司于2022年06月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-022），公司拟使用28,262.83万元（含利息及现金管理收益）超募资金投资建设“基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化”项目。公司已就该新增募投项目专户与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进度的议案》，同意使用超募资金增加募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”投资金额至28,591.63万元，其中拟使用超募资金追加投资金额为17,797.73万元，并将“总部基地及前沿技术研发项目”达到预定可使用状态的日期调整至2025年6月。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2024-048）。

在上述项目新增或调整后，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入 金额
1	闪存芯片升级研发及产业化项目	18,964.11	18,964.11
2	EEPROM 芯片升级研发及产业化项目	4,787.19	4,787.19
3	总部基地及前沿技术研发项目	28,591.63	28,591.63
4	基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目	28,262.83	28,262.83
合计		80,605.76	80,605.76

截至本公告披露日，上述募投项目中“闪存芯片升级研发及产业化项目”和“EEPROM芯片升级研发及产业化项目”予以结项，相关结余募集资金用于永久补

充公司流动资金。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。上述节余募集资金转出后，公司注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。上述募投项目相关的募集资金专户已于2023年6月1日前注销完毕，具体内容详见公司于2023年6月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-046）。

三、 本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募投项目为“总部基地及前沿技术研发项目”。截至本公告披露日，上述项目已投资完成，工程主体基本建设完成，公司已取得工程主体竣工报告，其募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额（1）	实际累计投资金额（2）	利息收入净额（3）	募集资金节余资金（1）-（2）+（3）
总部基地及前沿技术研发项目	28,591.63	24,029.26	548.46	5,110.83

注1：利息收入净额为截至2025年6月30日募投项目专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理收益；最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。

注2：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。

四、 本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、公司于2024年9月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进度的议案》，同意使用超募资金增加募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”投资金额至28,591.63万元，其中拟使用超募资金追加投资金额为17,797.73万元，追加该部分主要系工程建设费用投入的增加所致，公司将原计划2,000平方米的场地面积增

加到6,193平方米，并根据拟建设的总部基地的实际情况调整装修费用等各项综合成本，公司在进行场地购置的单价预算中根据调整预算当时的市场价预先进行估计，实际单价在后期相关部门审批确定后比原预算估计要低，使得项目资金有所节余。

2、该募投项目有一定时长的竣工整理周期，目前尚余部分待支付的装修项目尾款以及办公采购等，按计划将在未来运行过程中，结合合同条款及实际使用情况进行支付，现阶段形成一定节余。

3、公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入。

五、 节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”已投资完成，公司将上述募投项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将该募投项目截至2025年6月30日的节余募集资金5,110.83万元永久补充流动资金。上述节余募集资金含现金管理收益及利息净额，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。

节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

六、 专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上

海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。公司对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）保荐机构意见

中信证券认为：普冉股份将“总部基地及前沿技术研发项目”结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、 上网公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于普冉半导体（上海）股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年7月2日